

# 2023年3月期 第2四半期 決算説明資料

---

2022年11月18日



**内外テック株式会社**  
スタンダード3374

# 2023年3月期 第2四半期 連結業績

代表取締役社長 岩井田 克郎

## 業績

- **第2四半期は、売上高・利益ともに期初予想（5月13日公表）を上回り、前年同期比では大幅な増収増益を達成**
  - ⇒ メモリー投資に一服感が見られるも、ロジックや車載向け半導体など好調を維持
  - ⇒ 原材料不足などによるサプライチェーンの混乱が継続するも、納期管理や在庫積み増しなどにより着実なコントロールを実施
- **通期については、期初予想を据え置き**
  - ⇒ 売上・利益ともに過去最高を見込む
  - ⇒ 上期は順調に推移、下期はリスク要因を織り込む

## 予想を上回る大幅な増収増益 半期ベースで上場来最高を更新

(百万円、%)

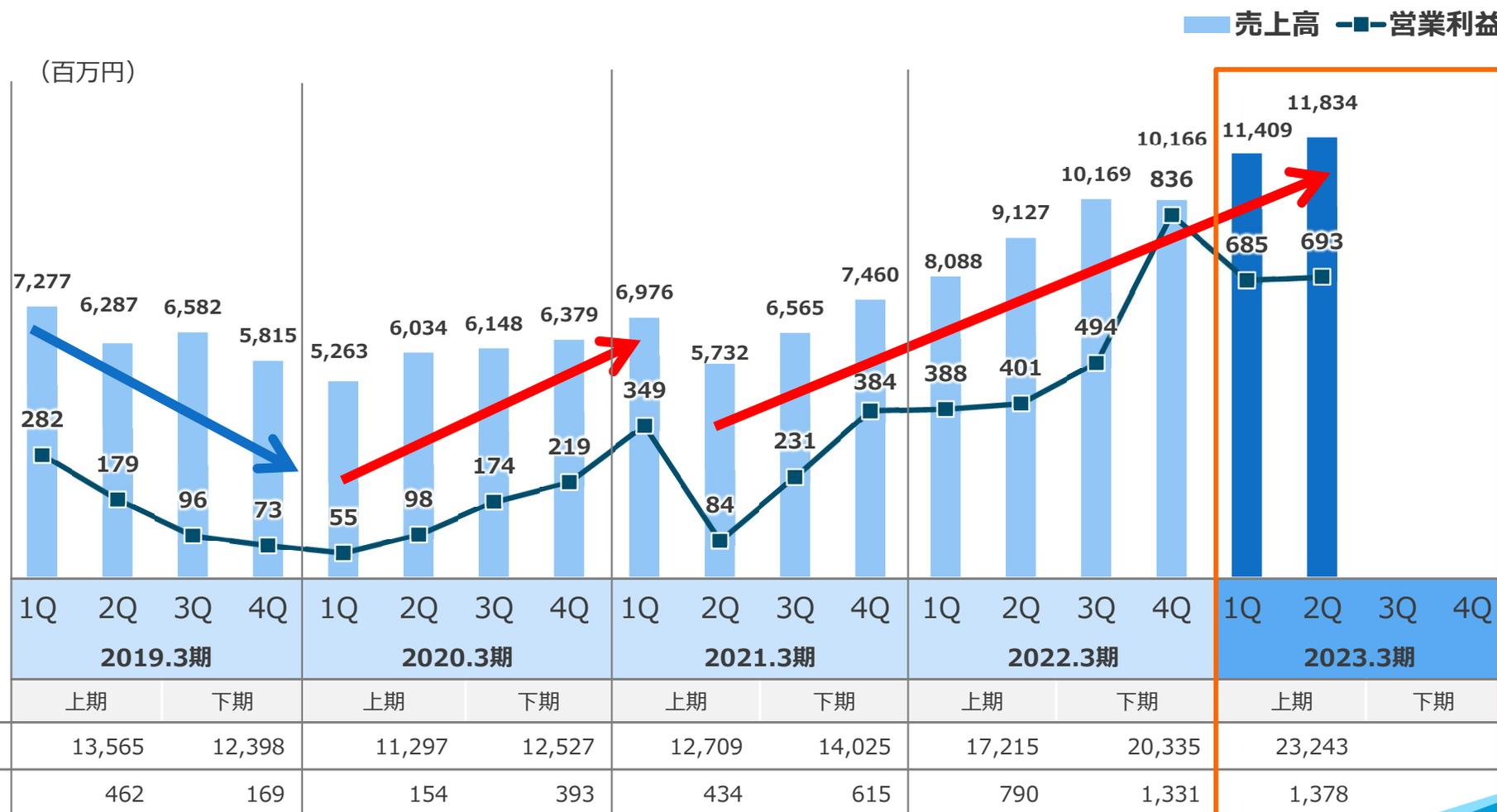
	2022.3期 上期			2023.3期 上期			期初予想
	実績	前年同期比	構成比	実績	前年同期比	構成比	
売上高	17,215	35.5	100.0	<b>23,243</b>	35.0	100.0	20,620
売上原価	15,272	36.0	88.7	<b>20,477</b>	34.1	88.1	-
販管費	1,152	10.3	6.7	<b>1,386</b>	20.3	6.0	-
営業利益	790	82.1	4.6	<b>1,378</b>	74.4	5.9	1,143
経常利益	781	83.5	4.5	<b>1,374</b>	75.9	5.9	1,132
親会社株主に帰属する 四半期純利益	527	92.5	3.1	<b>918</b>	74.0	4.0	756

- 売上高は、高速通信規格（5G）の普及やデータ通信量の増加等を背景にデータセンター投資や車載向けなど幅広い用途での半導体需要が堅調に推移したことから大幅な増収。
- 販管費は、取扱量の増加に伴い人件費・物流費を中心に増加するも、増収効果で販管費率は低下。
- 各段階利益は、増収効果により増加。

# 売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

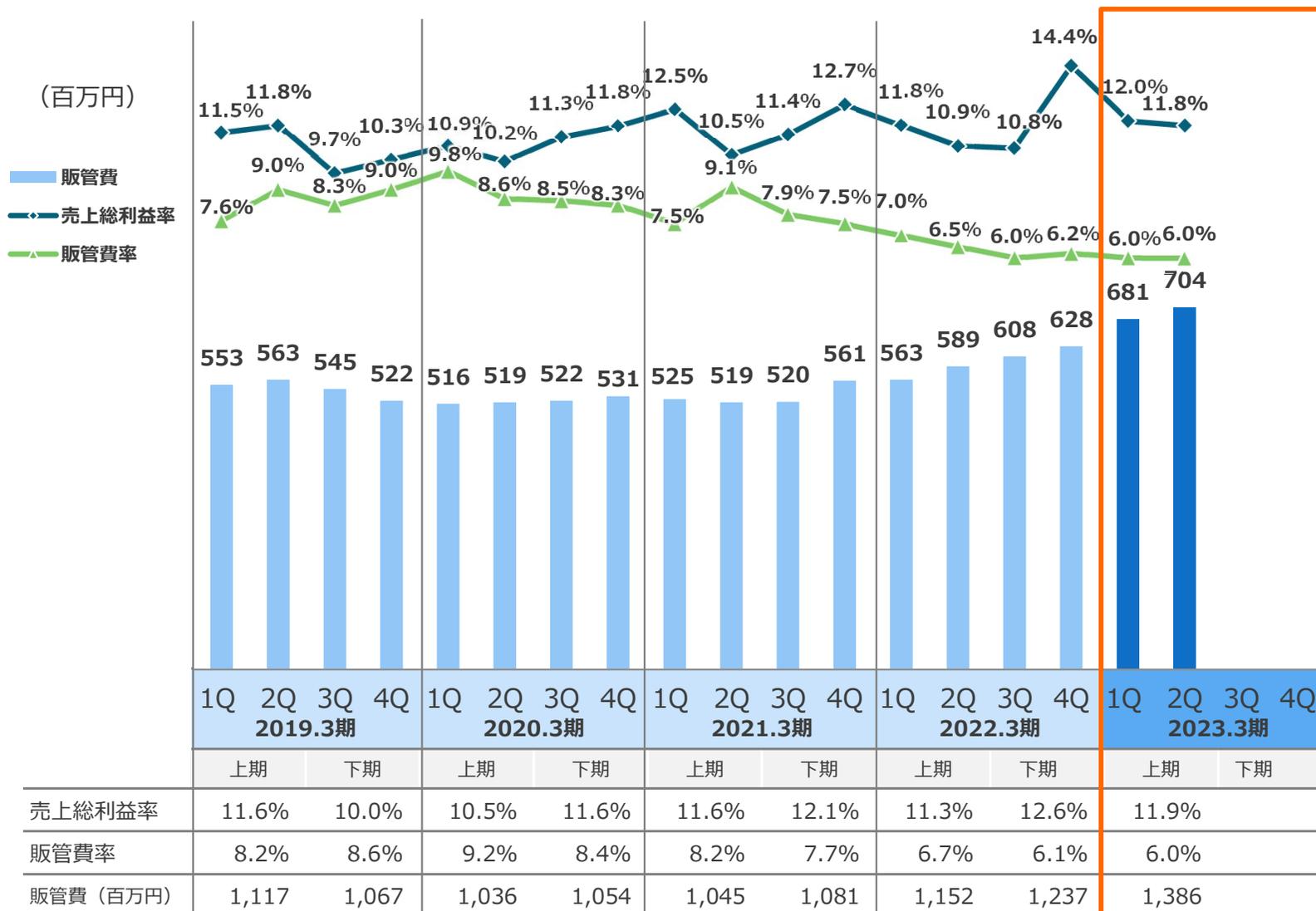
**売上高は、半期・四半期ベースともに上場来最高を更新**  
**営業利益は、半期ベースで上場来最高を更新**

- メモリー投資に一服感が見られるも、ロジックや車載向け半導体などが好調を維持し、増収増益



# 売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、生産性改善により前上期より改善  
販管費率は、増収効果により大幅に低下



## 売上総利益率

- 部材確保及び前期の増員人員の習熟度が向上し生産性が改善
- 2Qはインフレやエネルギー価格の高騰などによる原材料や仕入コストの増加から、売上総利益率は低下。

## 販管費・販管費率

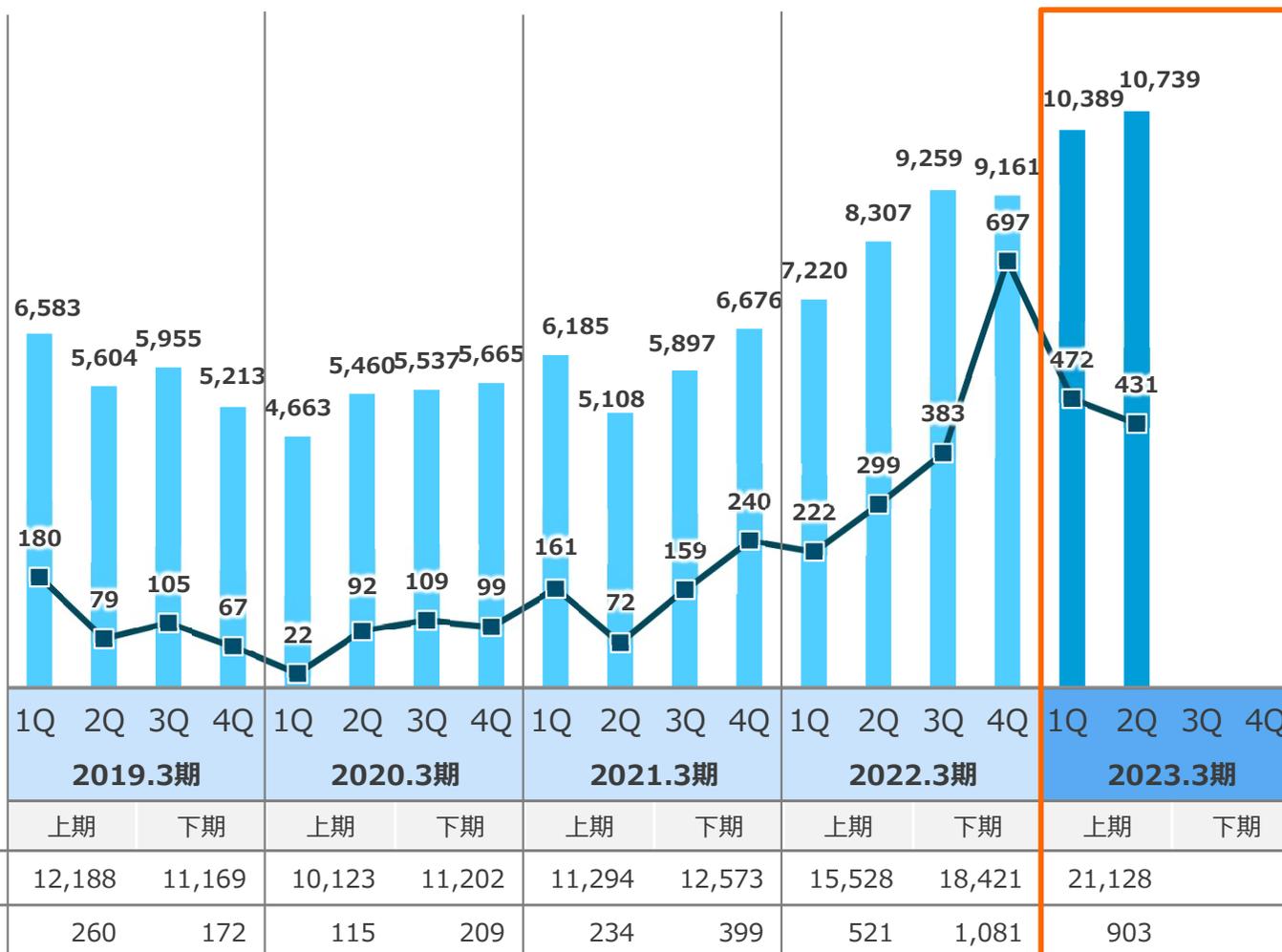
- 販管費は、取扱量の増加に伴い人件費・物流費が増加するも、効率化の推進により一定水準で推移。
- 増収効果により販管費率は低下傾向。

## 半期ベースで上場来最高の売上高を更新

(百万円)

■ セグメント売上高

■ セグメント利益



**セグメント売上高 21,128百万円**  
(前年同期比 36.1% )

- 5Gの普及やデータセンター向け、また自動運転など半導体需要の活況を受けてロジックや車載向けが堅調に推移し増収。

**セグメント利益 903百万円**  
(前年同期比 73.1% )

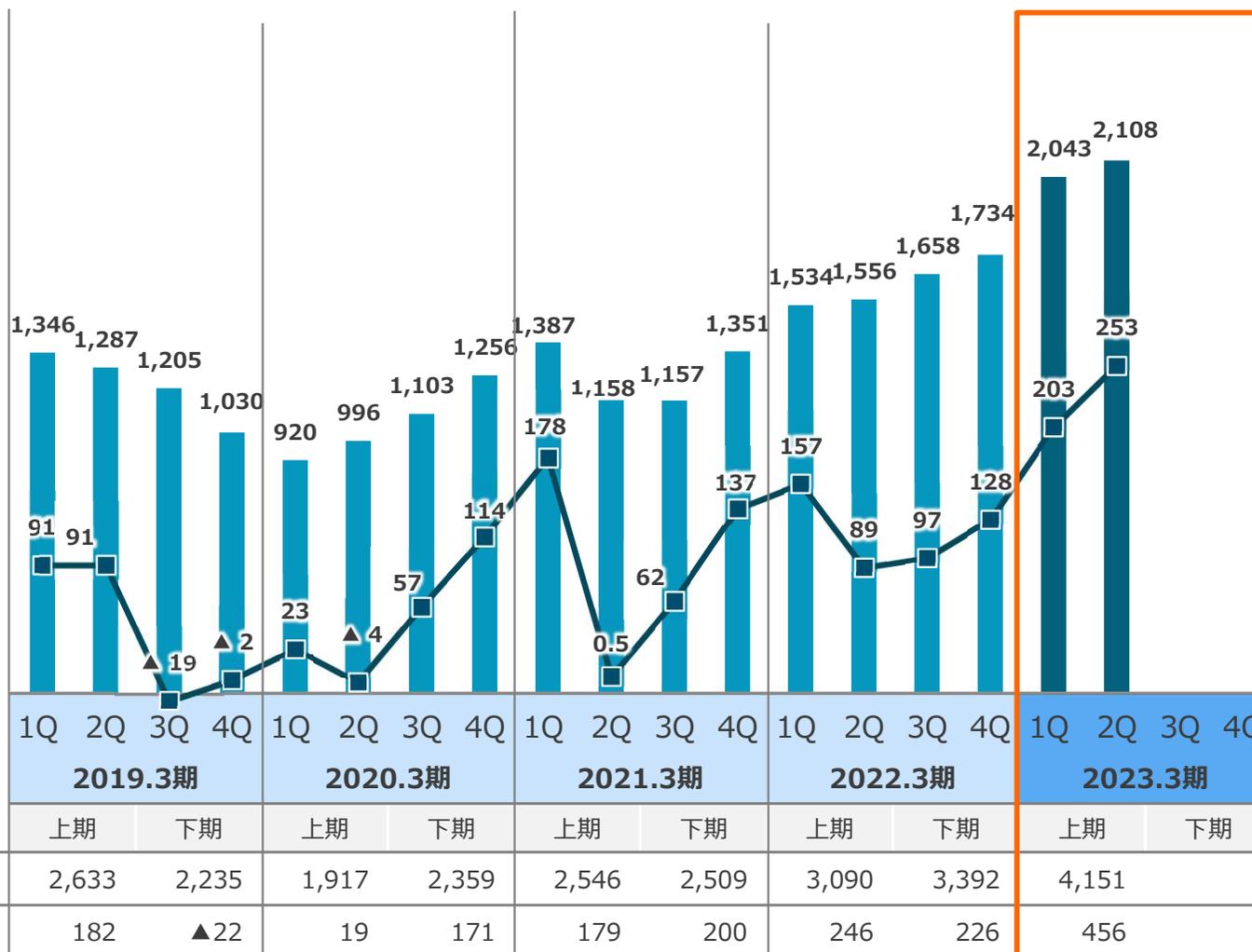
- 売上増加が寄与し、大幅な増益。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

## 半期・四半期ベースで上場来最高の売上高・利益を更新

(百万円)

■ セグメント売上高  
■ セグメント利益



**セグメント売上高 4,151百万円**  
(前年同期比 34.3% ↗)

- 半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、主要顧客の増産が続き増収。
- 前期実施の製造増員により生産量が増加し売上に寄与。

**セグメント利益 456百万円**  
(前年同期比 85.1% ↗)

- 部材確保及び前期の増員人員の習熟度が向上し、生産性が改善

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

# セグメント情報：受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

## ◆ マニファクチャリング・ソリューション



### 【事業内容】

顧客からの受託組立

### 【当期の概況】

- 半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、主要顧客の増産が続き受注が増加。また、部材確保が進み増収。
- 前期増員を行った製造員の習熟度の向上、及び部材確保による生産性が改善し増益。

## ◆ フィールド・ソリューション



### 【事業内容】

保守・メンテナンスサービス

### 【当期の概況】

- 前期増員による生産量増加が売上に貢献。また、半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、装置立上受注が増加し増収。
- 受注増により操業度が向上し利益率は改善。

## ◆ テクニカル・ソリューション

(百万円)

		2021.3期				2022.3期				2023.3期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
四半期ベース	売上高	57	20	6	5	7	5	9	12	3	7		
	利益	21	▲5	▲9	▲7	▲11	▲11	▲9	▲5	▲14	▲10		
半期	売上高	78		12		13		22		10			
	利益	15		▲17		▲22		▲14		▲25			

### 【事業内容と目的】

自社製品開発・技術開発

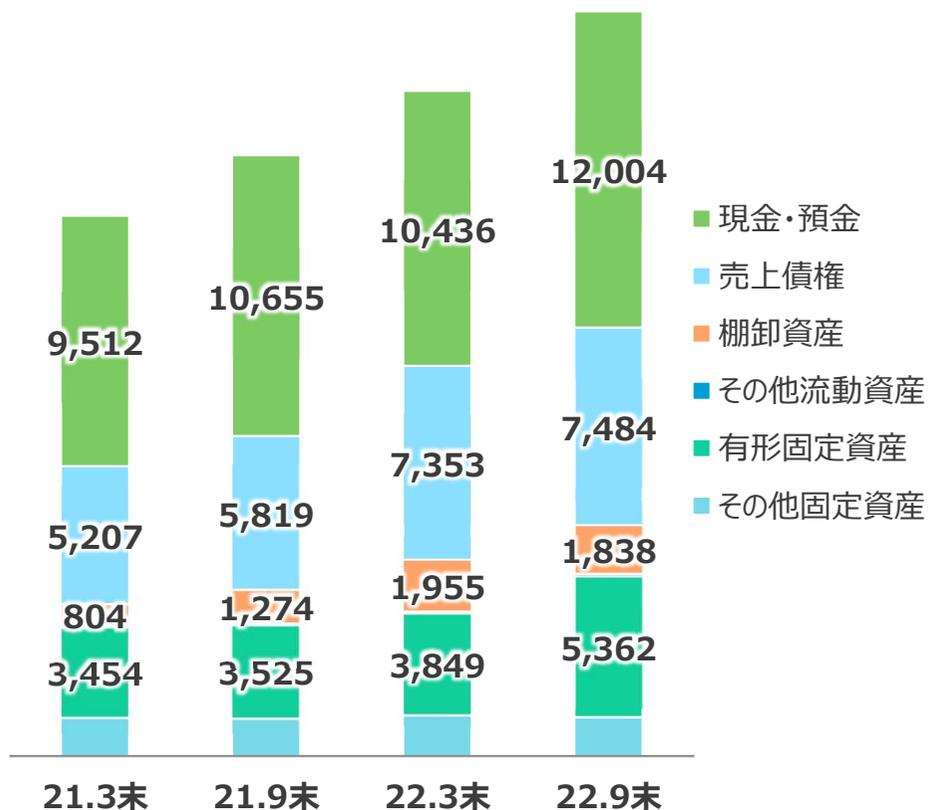
### 【当期の概況】

- 技術研修等、製品開発に必要な技術の習得への投資を継続中。中長期的な成長戦略の中核へ。

# 貸借対照表

## ◆ 資産

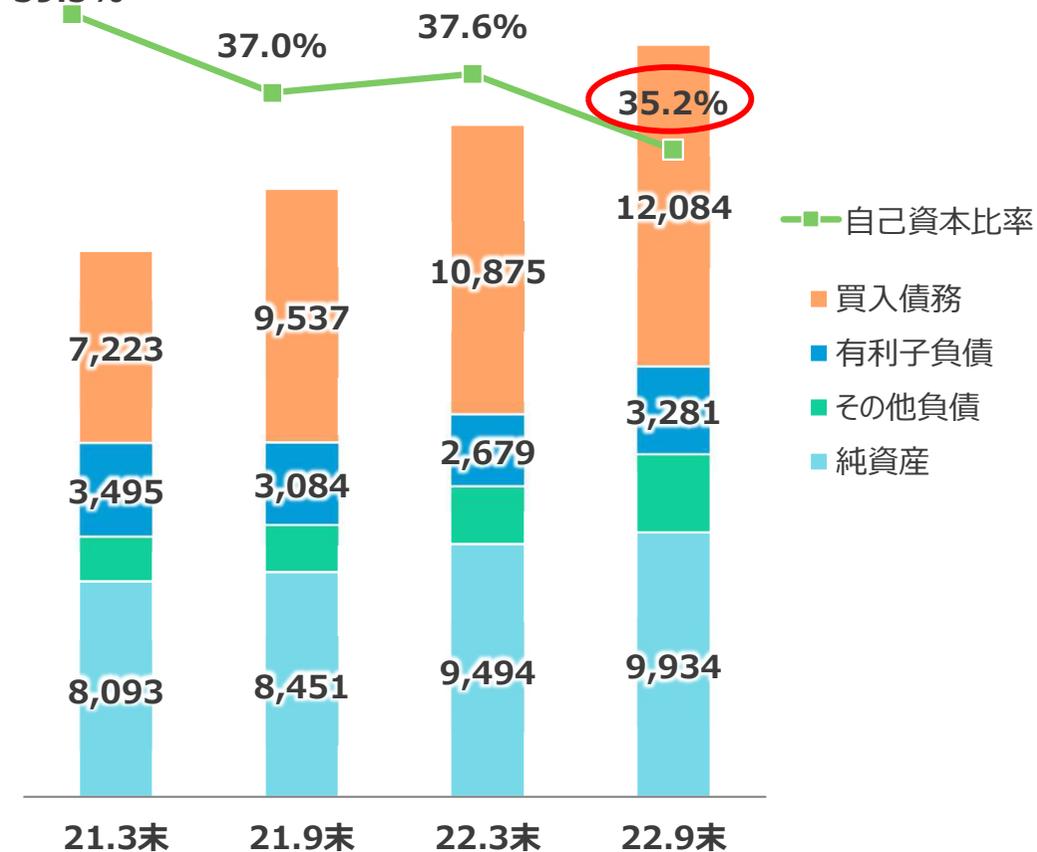
(百万円)



- 売上増及び借入により現預金は、15億67百万円増加。
- 江刺事業所新設による建設仮勘定が15億51百万円増加し、有形固定資産は53億62百万円に。

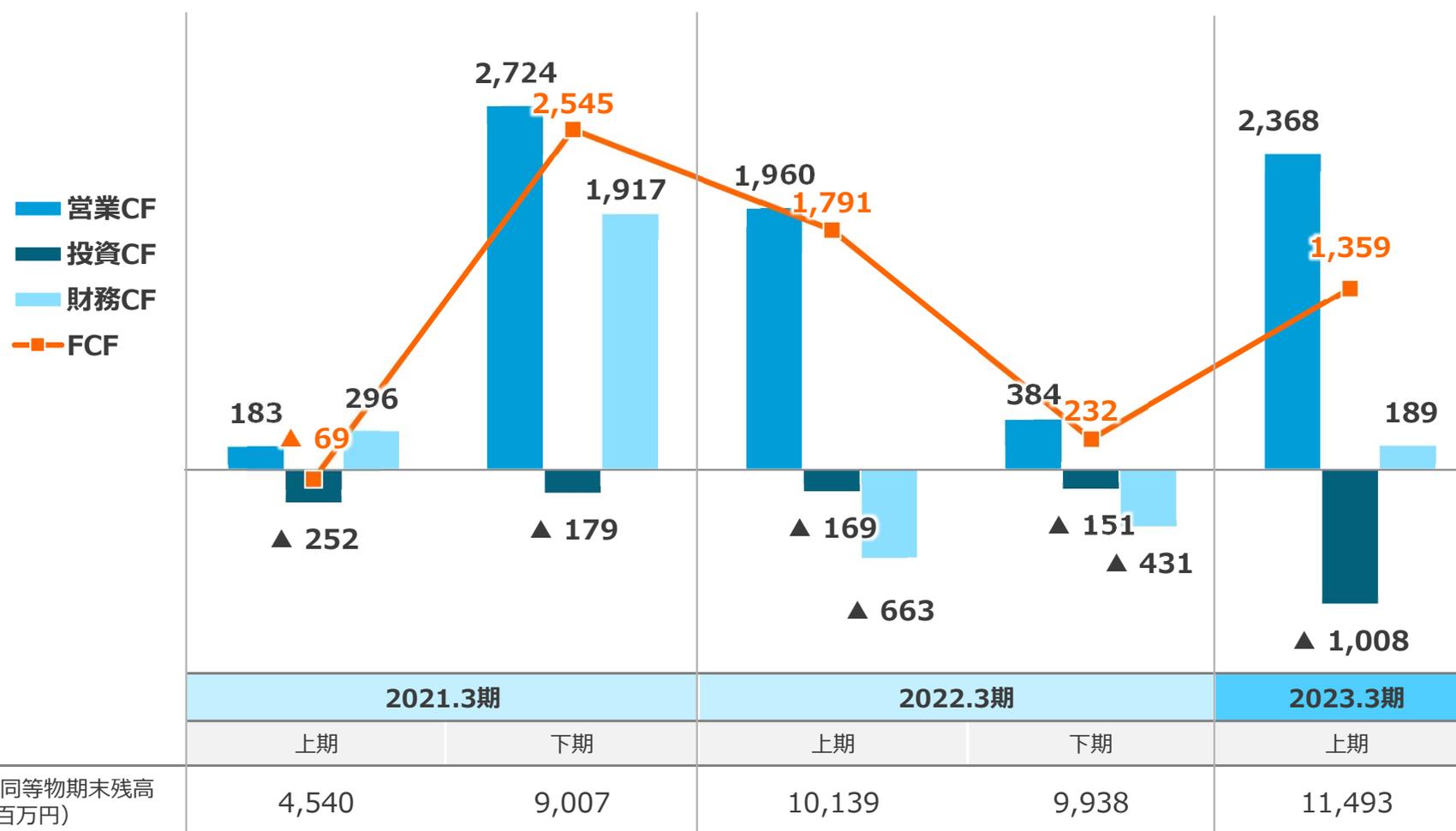
## ◆ 負債・純資産

(百万円)



- 売上増及び原材料確保のための先行仕入により、買入債務が12億8百万円増加。
- 有利子負債は、運転資金の他、江刺事業所建設に係る設備投資の借入により6億2百万円増加。
- 純資産は増加も、買入債務・有利子負債の増加で一時的に自己資本比率は低下。

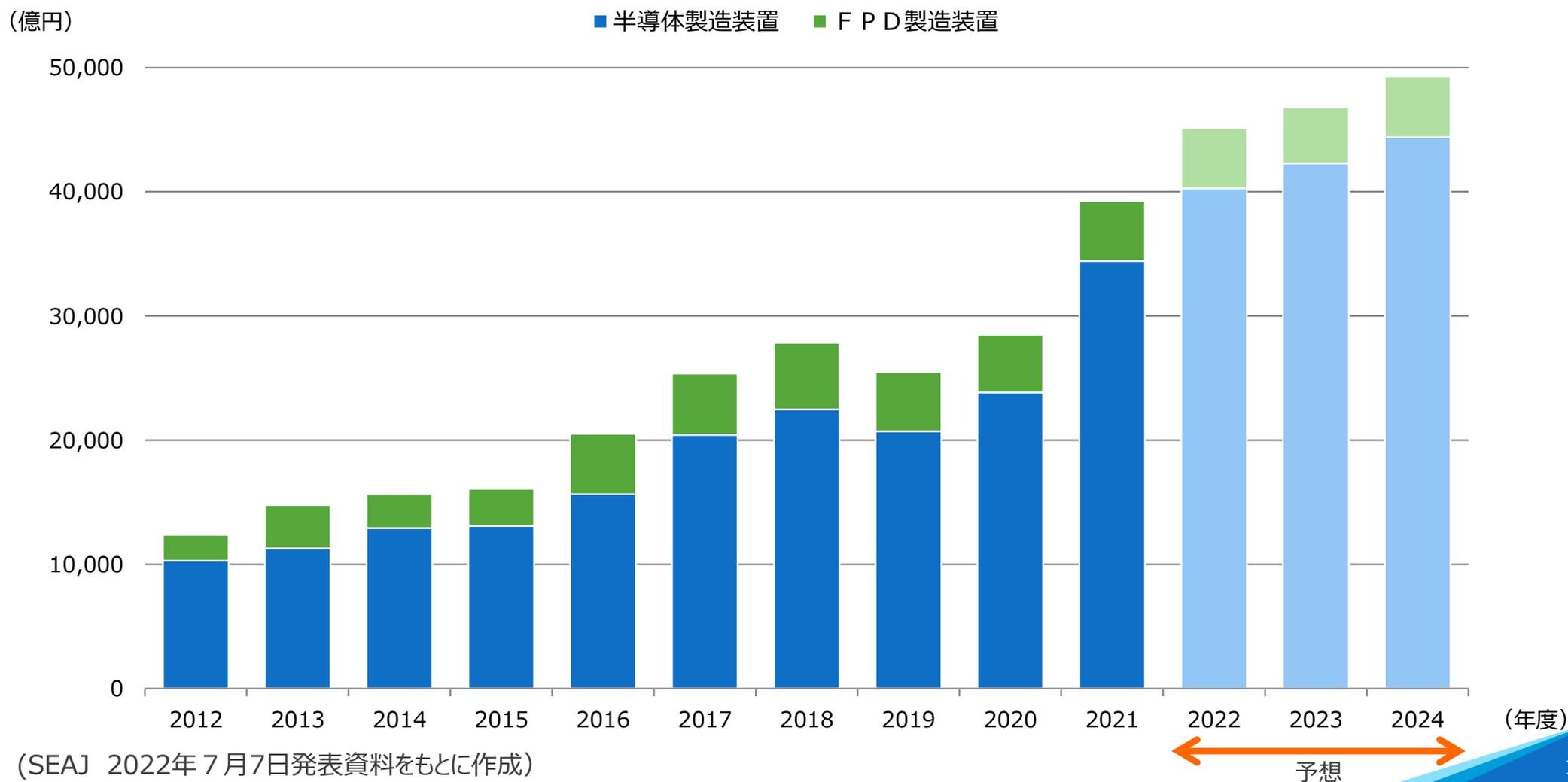
業績好調により営業キャッシュフローは、高水準を維持  
江刺事業所新設工事の支出により、投資キャッシュフローはマイナス  
現金及び現金同等物残高は、114億円に



# 2023年3月期 連結業績予想

## 半導体製造装置を取り巻く環境は、今下期からの減速懸念もあるが、 中期的な拡大傾向は続く

### 半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



景気減速懸念や地政学的リスクによる半導体メーカーの設備投資先送り等の業績低下リスクがあるも、上期の業績を踏まえ、通期予想を据え置き

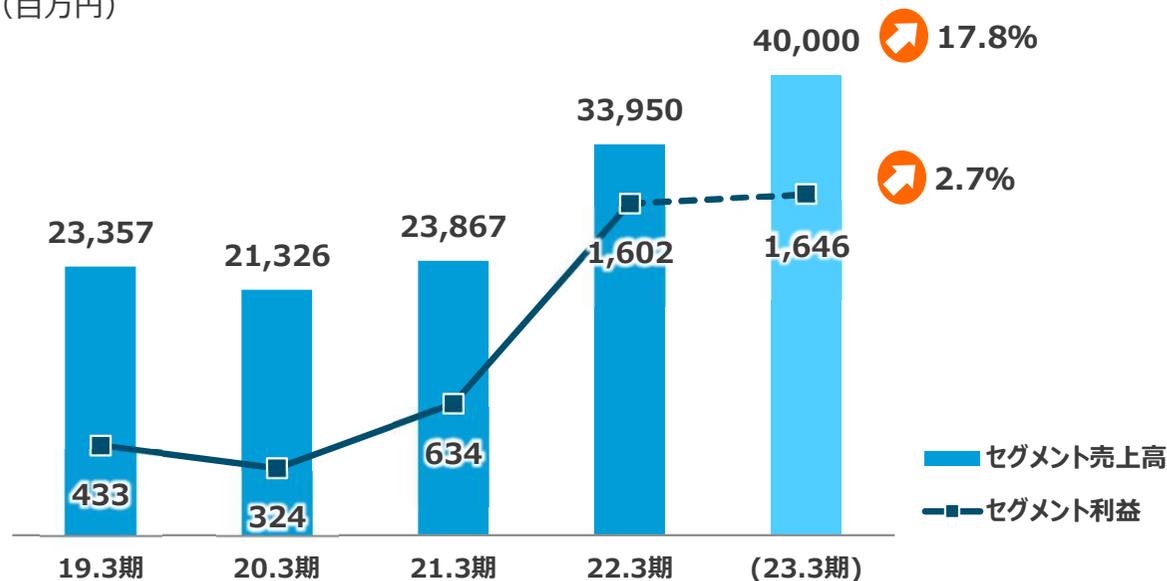
(百万円、%)

	2022.3期			2023.3期				
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	上期	上期進捗率 (対予想)
売上高	37,551	40.5	100.0	44,000	17.2	100.0	23,243	52.8
営業利益	2,121	2.0倍	5.7	2,360	11.2	5.4	1,378	58.4
経常利益	2,107	2.0倍	5.6	2,330	10.5	5.3	1,374	59.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,541	2.1倍	4.1	1,580	2.5	3.6	918	58.1

# セグメント予想 ⇒ 変更なし

## ◆ 販売事業

(百万円)



### セグメント売上高

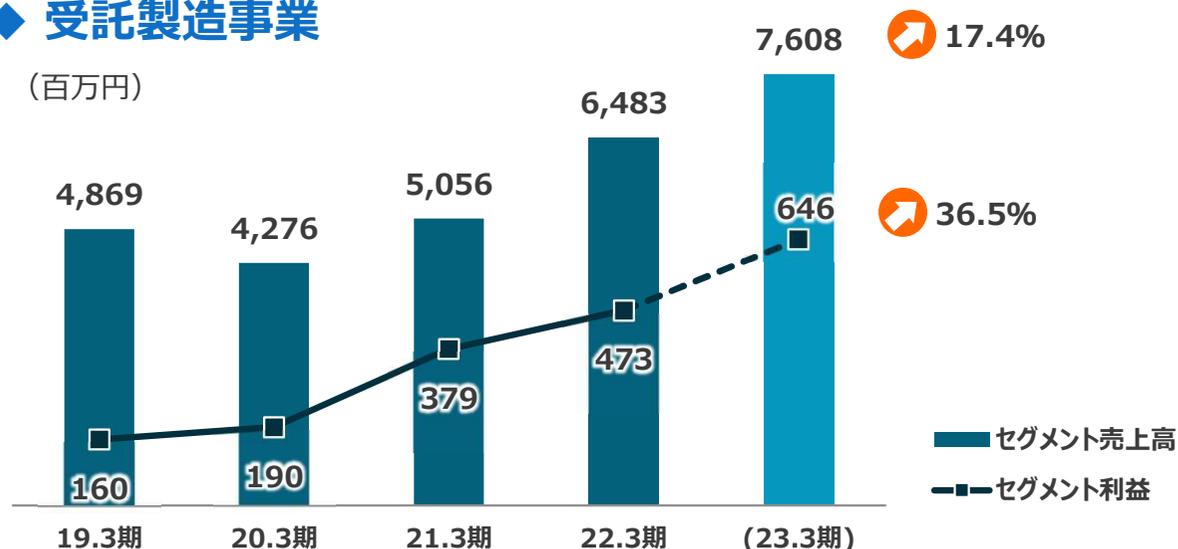
- 景気減速懸念や地政学的リスクによる半導体メーカーの設備投資先送り・抑制等の業績低下リスクがあるも、車載向け等一部の半導体需要の活況や部材確保のための先行受注を見込み、通期予想を据え置き。

### セグメント利益

- 仕入高のほか、人件費や物流費を中心とした販管費増加を見込むも、上期実績を踏まえ、通期予想を据え置き。

## ◆ 受託製造事業

(百万円)



### セグメント売上高

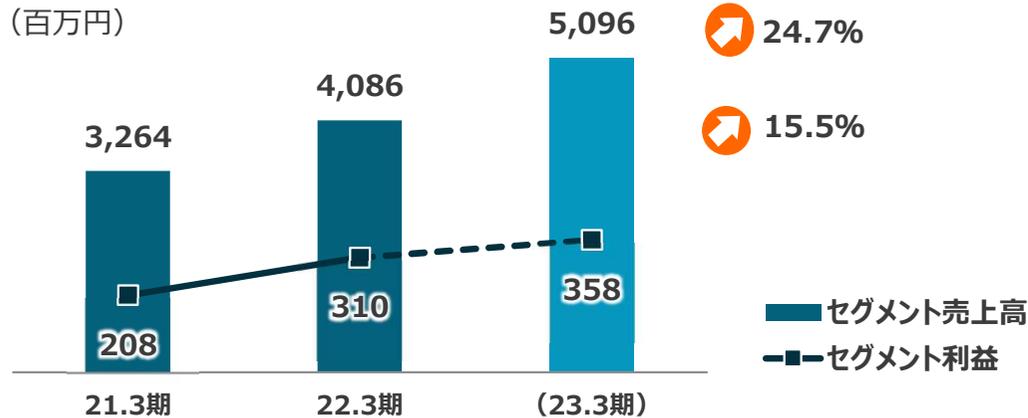
- 設備投資先送り・抑制等の業績低下リスクがあるも、上期の主要顧客の増産が寄与し、通期予想を据え置き。

### セグメント利益

- 材料高・製造人員の増員によるコスト増加を見込むも、損益分岐点操業度の改善や合理化により通期予想を据え置き。

(注) 売上高は連結調整前

## ◆ マニュファクチャリング・ソリューション



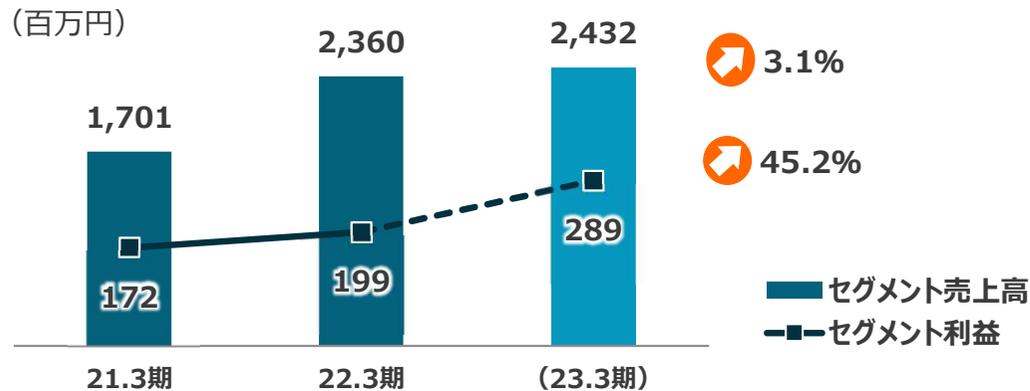
### セグメント売上高

- 設備投資先送り・抑制等の業績低下リスクがあるも、上期の主要顧客からの堅調な受注が寄与し、通期予想を据え置き。
- 仙台事業所の生産設備増設が寄与。

### セグメント利益

- 業績低下リスクに伴う減収・減速のリスクがあるも、上期の収益実績から、通期予想を据え置き。

## ◆ フィールド・ソリューション



### セグメント売上高

- 保守体制の強化により計画通りの推移。
- 設備投資先送り・抑制等による、業績低下リスクは限定的。

### セグメント利益

- 計画通りの推移。

## ◆ テクニカル・ソリューション

	21.3期	22.3期	(23.3期)
セグメント売上高	90	36	80
セグメント利益	▲1	▲36	▲1

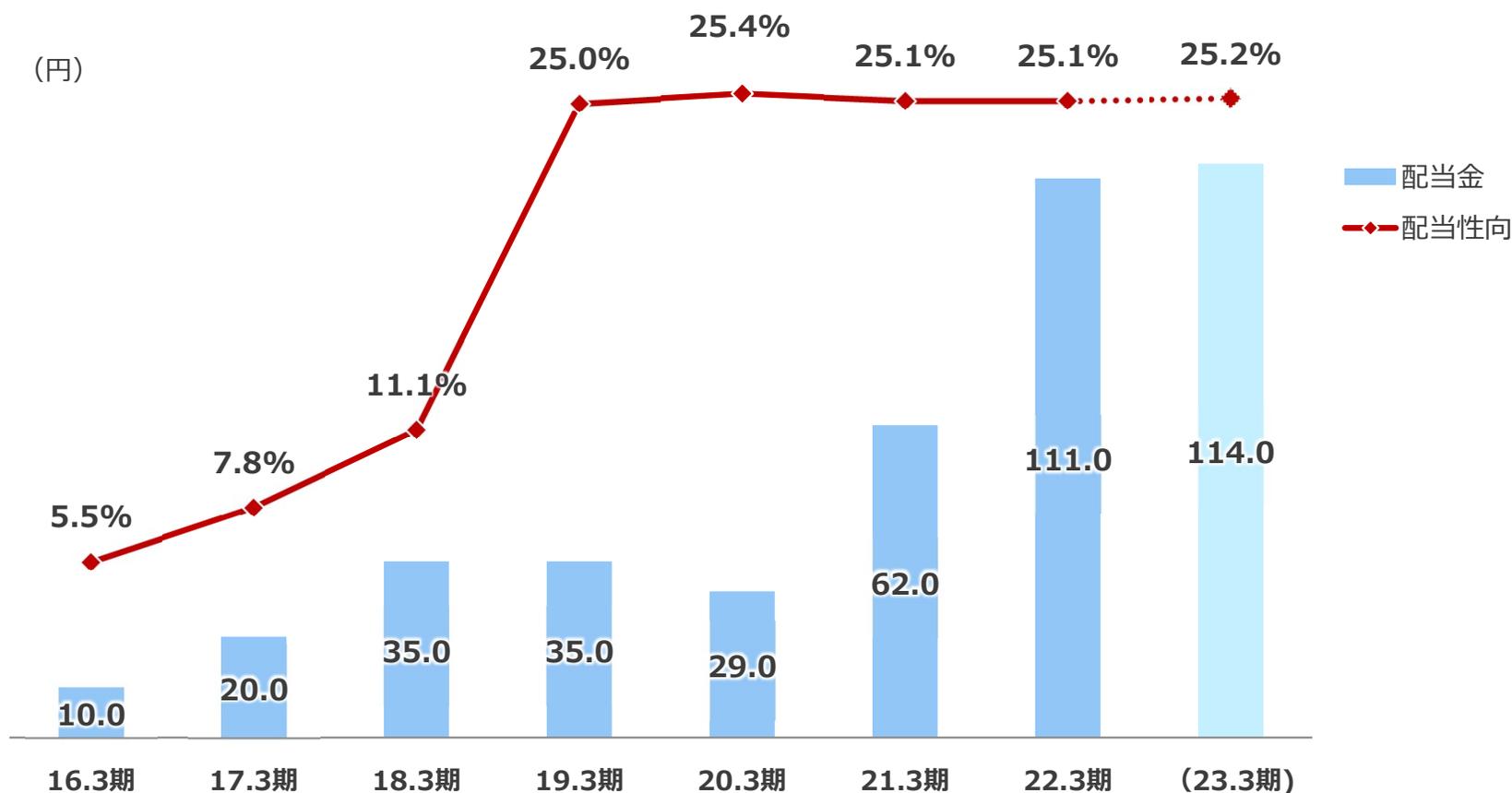
### セグメント売上高

- 高真空機器における新たな製造技術を要する製品への取り組み。

### セグメント利益

- 製造技術と生産の工夫・改善により、収益改善を見込む。

## 連結配当性向25%程度を基準 計画通り、配当予想は上場来最高の更新を見込む



(注) 配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→1株を考慮して過去遡及した数値を記載。

# **(参考資料)**

## **会社概要**

# 会社概要

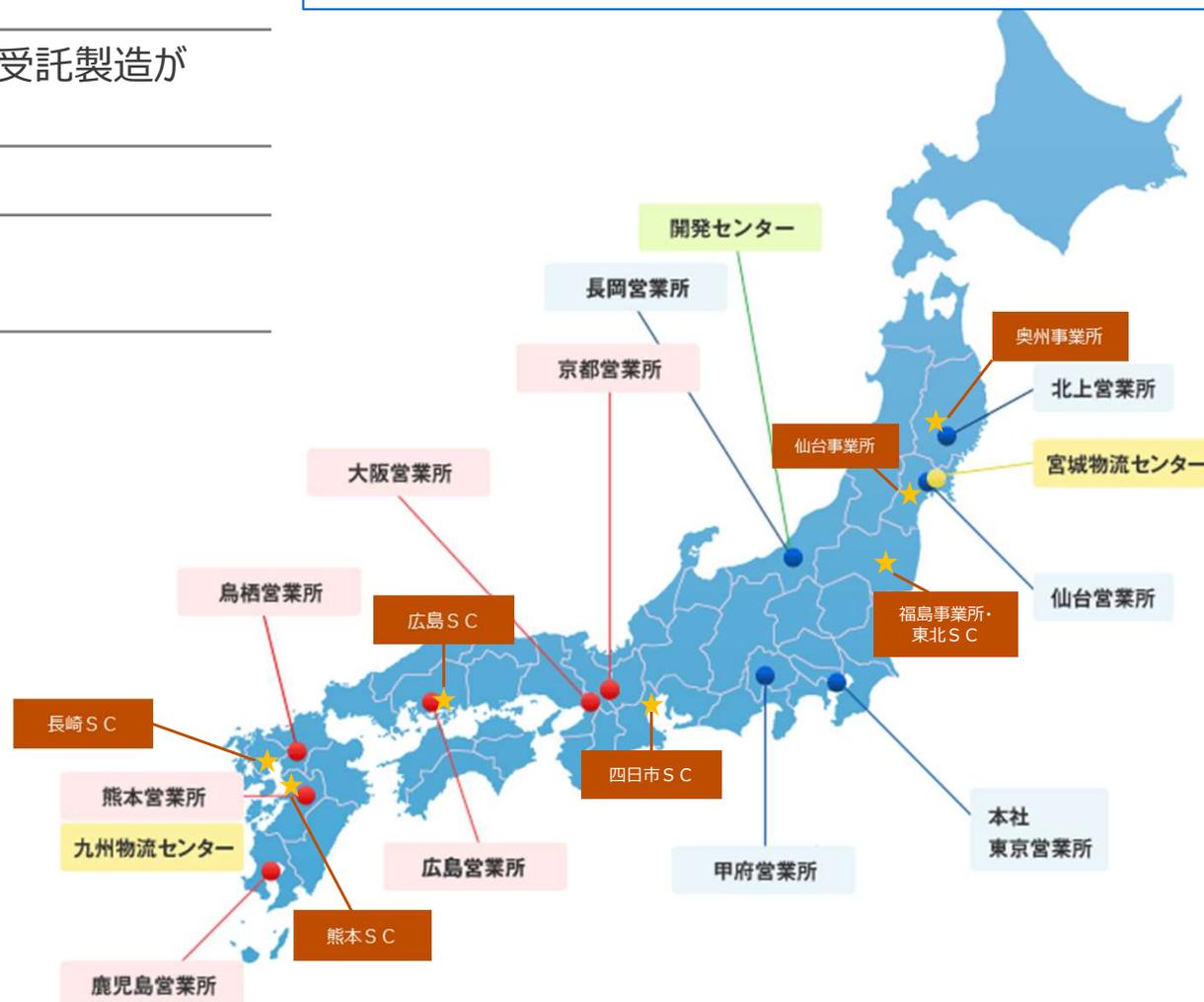
所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 671名（2022年9月末）
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材（上海）商貿有限公司

内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○  
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC) ★

中国・上海



納宜伽機材  
(上海)



## 半導体製造工程概要



5G対応のスマートフォンや基地局向け、自動車の自動運転向けなど半導体の需要増を背景に、前工程装置の設備投資は継続的な拡大が見込まれる。

内外テック  
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス  
受託製造メーカー

= モノづくりができるメーカー商社

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社